



电子级乙烯基硅油系列

主要组份

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

性能指标

产品型号	外观	密度 (25℃, g/cm ³)	粘度 (25℃, mpa. s)	乙烯基含量 (wt%)	挥发份 (150℃/3h, %)	D3~D10 (mg/kg)
RH-Vi70E	无色透明液体	0.96~0.97	70±10	1.46±0.04	≤0.2	≤300
RH-Vi100E	无色透明液体	0.96~0.97	100±15	1.06±0.03	≤0.2	≤300
RH-Vi500E	无色透明液体	0.96~0.97	500±50	0.42±0.03	≤0.2	≤300
RH-Vi1000E	无色透明液体	0.96~0.97	1000±200	0.32±0.02	≤0.2	≤300

特性及用途

本产品为乙烯基封端聚二甲基硅氧烷，采用特殊的合成工艺，产品不含钾、钠等金属离子，以及低挥发份和极低的残余混合环体量（D3~D10），从而确保优异的电性能。特别适用于制备硅晶片、半导体、光纤、航空电子等高端产品的涂层与封装。

包 装

衬塑铁桶或塑料桶。25KG/桶，200KG/桶。

贮 存

防止日光直照暴晒，远离明火，保持通风干燥。贮存期 2 年。超期检验合格仍可使用。

运 输

防止雨淋，日光暴晒。按非危险货物运输。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。